

# Memory Stick Micro™用连接器

SCNA系列



最小的贴装面积，最适合小型设备。

SD内存卡用

miniSD™卡用

microSD™卡用

W-SIM用



Memory Stick Micro™用

Memory Stick™用

组合式

Compact Flash™用

CardBus卡用

Express Card™用

CMOS摄影模块用

## 特长

- 不损害卡的小巧性的最小贴装面积。

## 用途

- 移动式电话，各种便携信息终端，数码相机，小型音频

## 主要规格

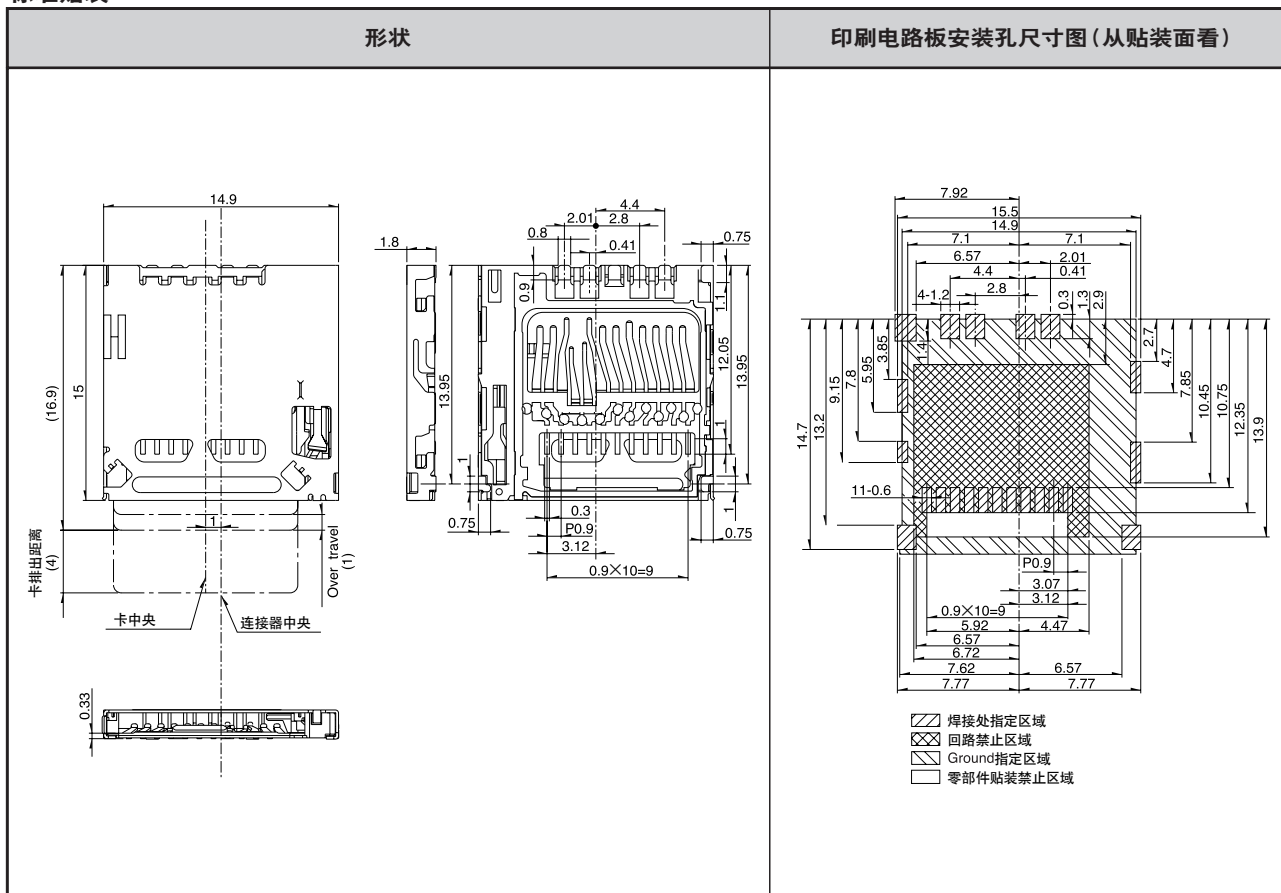
项目		规格
构造	合适的媒体	Memory Stick Micro™
	贴装方式	表面贴装型
	贴装状态	标准贴装
	媒体排出方式	双响键式
性能	使用温度范围	-25℃ to +60℃
	耐高压	250V AC 1minute
	绝缘电阻(初期)	1,000MΩ min.
	接触电阻(初期)	40mΩ max.
	插拔次数	12,000cycles

## 产品一览

媒体排出方式	贴装状态	基准距 (mm)	包装状态	产品编号
双响键式	标准贴装	0	贴纸	SCNA1A0300

外形图  
标准贴装

Unit:mm



SD内存  
卡用

miniSD™  
卡用

microSD™  
卡用

W-SIM用

Memory Stick  
Micro™用

Memory  
Stick™用

组合式

Compact  
Flash™用

CardBus  
卡用

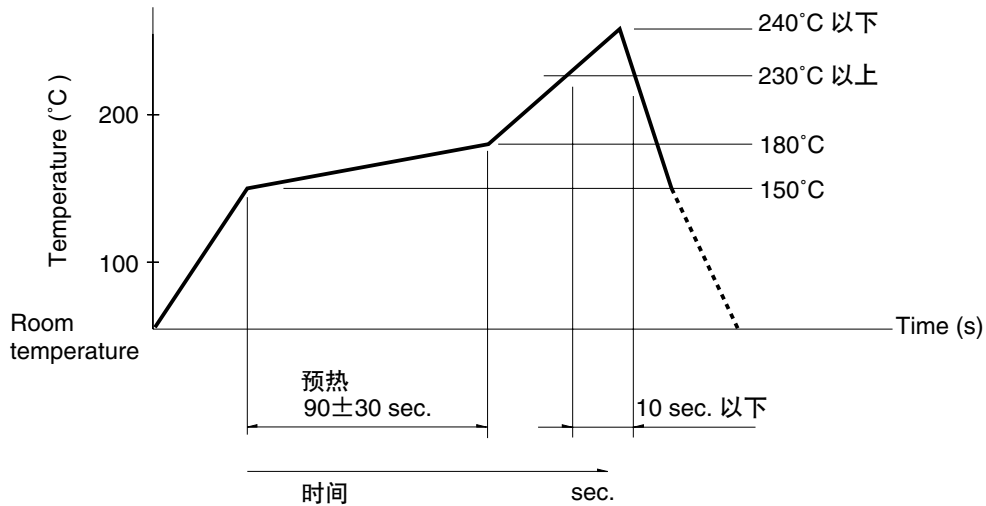
Express  
Card™用

CMOS  
摄影模块用

## 焊锡条件

### 回流方式的参考举例

1. 加热方式 为由热风循环的上下加热方式。
2. 温度测量方式 使用 $\phi 0.1 \sim \phi 0.2$ 的CA(K)或CC(T)测量。固定方式采用耐热胶带。
3. 温度分布(产品表面)。



## 使用时的注意事项

1. 在对端子进行焊接时, 请注意, 如果给端子施加负荷, 根据条件不同有造成松动, 变形及电特性降低的可能。
2. 焊接时, 水溶性助焊剂有使开关腐蚀的可能, 请避免使用。
3. 关于回流条件的设定, 请根据实际的批量生产条件进行确认。
4. 由于电路板的弯曲可能引起特性的变化, 请充分考虑模式设计及布局设计。
5. 本产品本来是为AV, 家电, 办公机器, 通讯机器等普通电子机器设计制造的。因此, 用于要求高安全性及可靠性的医疗, 航空, 宇宙机器, 防犯设备等时, 整机制造厂应充分确认该产品的适合性。
6. 产品对应符合SD Association (SDA) 规格、MultimediaCard (MMCA) 规格、Compact Flash Association (CFA) 规格、Memory Stick (TM) 规格书的卡。使用不符合上述规格的卡时, 可能不正常动作。

- SD内存卡用
- miniSD™卡用
- microSD™卡用
- W-SIM用
- Memory Stick Micro™用
- Memory Stick™用
- 组合式
- Compact Flash™用
- CardBus卡用
- Express Card™用
- CMOS摄影模块用